



## Produktliste bleihaltige Lotpaste in Dosen von Koki

Koki ist weltweit bekannt für seine technische Unterstützung, Produktentwicklung und Lieferketten-Organisation. Seit der Gründung 1964 werden High-Tech-Produkte für die Lötindustrie hergestellt. Koki entwickelt laufend neue Technologien, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.

Die folgenden Standardlegierungen von bleihaltiger Lotpaste repräsentieren nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm. Sollte die von Ihnen benötigte Legierung nicht aufgeführt sein, senden Sie uns bitte eine Anfrage.

### SE48-M955

### Bleihaltige Hochleistungs-No clean Lotpaste für Druckschablonen

### SS48-M955

Kontinuierliche Bedruckbarkeit mit Fine Pitch (0,5 mm / 20mil) und sogar Super-Fine-Pitch (0,4 mm / 16mil) für Anwendungen mit langer Schablonenleerlaufzeit. Sehr lange Schablonenleerlaufzeit und Abbindezeit bieten breites Prozessfenster. Sorgfältig ausgewählte Harze und Aktivatoren gewährleisten eine leistungsstarke Lotbenetzung. Die Flussmittelrückstände sind farblich unauffällig und bieten ein hervorragendes Erscheinungsbild.

Entspricht den Bellcore-Tests (Kupferspiegel, Halogenide, Oberflächenisolations-widerstand, Elektromigration) GR-78-CORE, Ausgabe 1.

Bestell Nr.	Bezeichnung	Legierung	Korn	Flux	Dose à	Schmelztemp.
1058	SE48-M955	Sn93/Pb37	3	ROLO	500 g	183°C
1015	SS48-M955	Sn62/Pb36/Ag2	3	ROLO	500 g	179 - 190°C

### SS48-M956-2

### Bleihaltige No clean Lotpaste mit Anti-Kissen-Effekt für Druckschablonen

Kontinuierliche Bedruckbarkeit mit Fine Pitch (0,5 mm / 20mil) und sogar Super-Fine-Pitch (0,4 mm / 16mil) für Anwendungen mit langer Schablonenleerlaufzeit. Sorgfältig ausgewählte thixotrope Materialien sorgen für eine hervorragende Konturenstabilität. Das Auftreten von Brückenbildung und solder beading wird deutlich reduziert. Garantiert Verbindungsfestigkeit aufgrund ausgezeichneter Benetzung. Durch gründliche Forschung und Entwicklung wurde ein sorgfältig ausgewähltes Flussaufbau-System gewählt, welches das Auftreten von Fehlstellen deutlich reduziert. Mit dem speziell entwickelten wärmebeständigen Flussmittel wird eine schnellere Benetzung erreicht, was Kissenefekte beseitigt.

Bestell Nr.	Bezeichnung	Legierung	Korn	Flux	Dose à	Schmelztemp.
1200	SS48-M956-2	Sn62/Pb36/Ag2	3	ROLO	500 g	179 - 190°C
1200/250	SS48-M956-2	Sn62/Pb36/Ag2	3	ROLO	250 g	179 - 190°C



**SSA48-M955 Bleihaltige No clean Lotpaste (Anti-tombstoning) für Druckschablonen**

Kontinuierliche Bedruckbarkeit mit Fine Pitch (0,5 mm / 20mil) und sogar Super-Fine-Pitch (0,4 mm / 16mil) für Anwendungen mit langsamer bis schneller (20-100mm / sec.) Druckgeschwindigkeit auch bei langer Schablonenleerlaufzeit. Sorgfältig ausgewählte thixotrope Materialien sorgen für eine hervorragende Konturenstabilität. Das Auftreten von Brückenbildung und solder beading wird deutlich reduziert. Das speziell entwickelte Flussmittel gewährleistet eine extrem hohe Zuverlässigkeit und eine überlegene Lotbenetzung. Extrem lange Schablonenleerlaufzeit und Abbindezeit bieten breites Prozessfenster. Ein kleiner Prozentsatz von Antimon (Sb) vermindert die Oberflächenspannung des flüssigen Lots und reduziert als Folge davon Grabsteineffekte drastisch.

Bestell Nr.	Bezeichnung	Legierung	Korn	Flux	Dose à	Schmelztemp.
3065	SSA48-M955	Sn62.6/Pb36.8/Ag0.4/Sb0.2	3	ROLO	500 g	179 - 190°C

Lieferzeiten auf Anfrage oder im E-Shop ersichtlich

Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter können Sie per Mail bei uns anfordern.

26.08.2015 is